



2007年10月11日
SOI 業界コンソーシアム

エレクトロニクス業界のリーダー企業 19 社が結集、SOI (シリコン・オン・インシュレータ) のイノベーションをより多くの市場へ促進

コストの削減と新規市場への参入を目指し、SOI 業界コンソーシアムが発足

マサチューセッツ州ボストン (2007 年 10 月 8 日 発) - エレクトロニクス業界全体をリードする企業各社は本日、シリコン・オン・インシュレータ (SOI) 技術のメリットを訴え、採用への障害をなくし SOI のイノベーションをより多くの市場へ普及させるため、SOI 業界コンソーシアムを発足したと発表しました。

性能と消費電力は今や、エレクトロニクス業界全体で大きな課題となっています。SOI が、こうした課題を解消する際の強力なソリューションであることは、同技術をいち早く採用した企業各社によって明確に実証されており、このような企業は、課題の多くを自らの手で解決しています。採用企業の次の波を実現するためには、容易に利用可能で、かつ実績のある SOI の設計プラットフォームと IP (知的財産) を包括的に取り揃えることで、透明性の高い設計プラットフォームと、コスト効果の高い製造体制を確保することが求められます。SOI コンソーシアムは、採用に伴うコストを削減し、SOI のベストプラクティスを確保し、さらにバリューチェーン全体で設計サンプルの充実化を図ることで、現実的な溝と認識上の溝を同時に埋めることを目標としています。

コンソーシアム創設メンバーは、ユーザー、イネーブラー型企業、サプライヤー、メーカーを幅広く網羅した次の通りです。Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)、ARM 社、米国ケイデンス・デザイン・システムズ社、フランス原子力庁電子・情報技術研究所 (CEA-Leti)、Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd.、フリースケール・セミコンダクタ・インク、IBM、米 Innovative Silicon 社、KLA-Tencor Corp.、Lam Research Corp.、NXP Semiconductors、サムスン、Semico Research 社、Soitec 社、S.E.H Europe.Ltd.、STMicroelectronics、米国シノプシス社、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC)、United Microelectronics Corp. (UMC) (アルファベット順)。

コンソーシアムの議長に選出されたアンドレ=ジャック・オーバートン=ハーブ (André-Jacques Auberton-Hervé) は、次のように述べています。「SOI はこれまで、性能の波に乗って急速に普及してきましたが、現在では、消費電力の削減にも重点を置いています。SOI は、消費電力を大幅に削減することができるため、データセンターを運用する場合や、携帯電話上で試合を最後まで観戦するのに十分なバッテリーが必要な場合には、大きなメリットがあります。ユーザーとイネーブラー型企業を一体化することで、SOI 業界コンソーシアムは、設計チェーンの中のギャップを見つけ、これを埋めることができます。その結果、より広範な市場において、設計者に現実的な選択肢を提供できます。」

SOI 業界コンソーシアムは今後、以下の 3 つの大きな目標に取り組んでいきます。

- ユーザーのニーズに耳を傾け、これを理解、対処するよう努めること
- エコシステム内で必要不可欠なコラボレーションを促進し、シリコン実証済みのソリューションを実現すること
- より広範なエレクトロニクス・コミュニティの中で、SOI のメリットと技術革新、勢いに対する理解を広めること

ガートナーの半導体担当リサーチバイスプレジデント、ブライアン・ルイス (Bryan Lewis) 氏は、次のように述べています。「SOI は今や、業界の主流になろうとしています。業界全体が SOI に投資することで、さまざまな機器とアプリケーションが、低消費電力化と高性能化が明確に加速するはずです」

初期の採用企業によってすでに確立されたベストプラクティスを共有すること、そして、設計上の新たな証拠を提示することで、SOI の性能、消費電力、面積の優位性を実証することがコンソーシアムの当面の目標です。理事会の選任は、今年の 10 月を予定しています。

SOI 業界コンソーシアムについて

SOI 業界コンソーシアムは、シリコン・オン・インシュレータ (SOI) 技術のメリットを訴え、採用への障害を解消することで、SOI の技術革新を広範な市場に普及させることを目指しています。同コンソーシアムは、エレクトロニクス業界全体を支えるリーダー企業各社によって設立され、創設メンバー企業は、Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)、ARM 社、米国ケイデンス・デザイン・システムズ社、フランス原子力電子・情報技術研究所 (CEA-Leti)、Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd.、フリースケール・セミコンダクタ・インク、IBM、米 Innovative Silicon 社、KLA-Tencor Corp.、Lam Research Corp.、NXP Semiconductors、サムスン、Semico Research 社、Soitec 社、S.E.H Europe.Ltd.、STMicroelectronics、米国シノプシス社、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC)、United Microelectronics Corp. (UMC)、(アルファベット順) です。コンソーシアムには、エレクトロニクス業界全体のあらゆる企業と機関が参加することができます。詳細については、www.soiconsortium.org をご覧ください。

セーフ・ハーバー条項

SOI 業界コンソーシアムが SOI 業界コンソーシアム事務局、本リリース、またはその他の資料により表明する見解や意見は、必ずしも個々メンバーによる見解、もしくは意見を表したものではありません。SOI 業界コンソーシアム事務局がコンソーシアムを代表して発言する場合、これはコンソーシアムに属するメンバー企業を代表するものではなく、SOI 業界コンソーシアムの見解を代表しているものです。見解と意見は通知なしに変更される場合があり、SOI 業界コンソーシアムは本リリースに記載された情報またはそれに付随するディスカッションを更新する義務は負いません。

本プレスリリースに関するお問い合わせ：

広報代理店：オグルヴィ・パブリックリレーションズ・ワールドワイド・ジャパン株式会社
藤原 亜希子、齊藤真帆

Tel: 03-5793-2341 / 2374

Email: akiko.fujiwara@ogilvy.com, maho.saito@ogilvy.com

<参考資料> SOI業界コンソーシアムの設立に関する各社コメント (翻訳版)

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

「AMDにとって、SOIは高性能でエネルギー効率の高いマイクロプロセッサを広範に構築できる理想的なプラットフォームです。性能と低消費電力の組み合わせというSOI独自の長を活用することにより、AMDはx86製品のイノベーションにおいてリーダー企業としての座を維持することができます」

AMD Fab 36 ヴァイス・プレジデント ウド・ノセファ (Udo Nothelfer)

プレスコンタクト: ゲリー・シルコット (Gary Silcott)、AMD、Eメール: gary.silcott@amd.com

ARM社

「プロセッサと物理IPのリーダー企業であるARMは、電力効率に最も優れた製品を業界に提供することに注力しています。半導体業界がSOIの広範な採用を開始しようとしている現在、本コンソーシアムにARMが加わることは、顧客によるSOIの利用を加速するものと確信しております」

物理IP マーケティング ヴァイス・プレジデント トム・ランチエ (Tom Lantsch)

プレスコンタクト: ナンディタ・ギアディンク (Nandita Geerdink)、Text 100、電話: +1-415-593-8457、Eメール: naarm@text100.com、クラウディア・ナタリア (Claudia Natalia)、スティーブン・テイラー (Steve Taylor)、ARM社、電話: +1-408-548-3172、+44 (0) 1223 406 025、Eメール: claudia.natalia@arm.com、steve.taylor@arm.com

米国ケイデンス・デザイン・システムズ社

「設計技術はSOI業界に不可欠ですが、当社の製品は数多くの優れたSOI設計に使用されています。EDAのリーダー企業であり、SOIコンソーシアムのメンバーであるCadenceは、顧客による次世代SOI設計を支援し、SOI業界のイノベーションを加速していく所存です」

コーポレート・マーケティング&ストラテジー、ヴァイス・プレジデント、クレイグ・ジョンソン (Craig Johnson)

プレスコンタクト: マイケル・フォーネル (Michael Fournell)、米国ケイデンス・デザイン・システムズ社、電話: +1-408-428-513
Eメール: fournell@cadence.com

フランス原子力電子・情報技術研究所 (CEA-Leti)

「CEA-Létiは、SmartCut™技術とSOI設計のイノベーションを所有し、先進的なSOI基盤におけるCMOSとRF研究における業界リーダーです。我々は、世界を代表する業界リーダーが集うSOIコンソーシアムに参することで、SOIにおけるバリューチェーンの専門知識を紹介し、この最先端技術の応用範囲を拡大していきたいと思っております」

最高経営責任者 (CEO)、ローラン・マリエ (Laurent Malier)

プレスコンタクト: マリー・ノエル・セメリア (Marie-Noelle Semeria)、CEA-Léti、Eメール: marie-noelle.semeria@cea.fr

Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd.

「エンドマーケットでは、消費電力、性能、コストを管理できる画期的な手法を求められています。SOI は、コンピューティングおよびゲームアプリケーションの消費電力や性能比を改善するための触媒であり、当社のファウンドリ事業における成長エンジンです。SOI コンソーシアムの創立メンバーとして、Chartered は、エンドマーケットの期待に応えるため、同様なイノベーションを通じて複雑な課題を解決しなければならない他の市場セグメントにも、SOI の価値の提案をしたいと考えています」

インダストリ マーケティング&プラットフォーム アライアンス、ヴァイス・プレジデント、ケビン・メイヤー
(Kevin Meyer)

プレスコンタクト: ティファニー・スパークス (Tiffany Sparks)、Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd、
電話: +1-408-428-513、E メール : tiffanys@charteredsemi.com

フリースケール・セミコンダクタ・インク

「フリースケールは自社のプロセッサ・ロードマップにおいて、長年 SOI 技術を採用しています。SOI コンソーシアムが設立したことで、SOI 技術はより多くのアプリケーションで採用され、消費電力を削減しながら、決定的な性能の強化をシステムレベルで継続できる手段として、より多くのエンドユーザーに利用してもらえるようになります」

シニア・ヴァイス・プレジデント兼最高技術責任者 (CTO)
リサ・スウ (Lisa Su)

プレスコンタクト: アンドリュウ・ノース (Andrew North)、フリースケール・セミコンダクタ・インク、電話:
+1-512-203-7169、E メール : andy.north@freescale.com

IBM

「IBM は長年にわたり、業界のリーダー企業と自社の技術を共有し、コラボレーションとオープンなコミュニティ発展の促進に取り組んできました。IBM のシステムをリードする中心的な役割を果たしてきた SOI なら、広範な用途において従来の仕組みを変革できると思っています。IBM は、クライアントからの SOI に対する需要に対し、従来は 45nm ASIC、直近には 130nm RF といった OEM 製品によって応えてきました。SOI 技術が広く普及し、その性能と消費電力に関する特長が活用されるよう、SOI コンソーシアムと密接に協力していく予定です」

半導体プラットフォーム、ヴァイス・プレジデント、マーク・アイルランド (Mark Ireland)

プレスコンタクト: キャサリン・ヘルツェマン (Catherine Helzerman)、GES コミュニケーション・マネージャ、
IBM、電話: +1-408-677-9813、E メール : cahelzer@us.ibm.com

米 Innovative Silicon 社

「ISi は、SOI 業界コンソーシアムの設立メンバーとなったことを誇りに思います。当社の Z-RAM メモリ IP のような SOI ベースのデバイスは、バルク CMOS と比較して優れたパワー、性能、密度、コストアドバンテージを発揮することが可能です。このコンソーシアムに集まった業界リーダーは、近い将来に SOI 設計と技術を広く活用されるものとするに違いありません」

マーケティング、ヴァイス・プレジデント、ジェフ・ルイス (Jeff Lewis)

プレスコンタクト: リック・ガーン (Rick Gaan)、E メール : rgaan@z-ram.com

KLA-Tencor Corp.

「SOI 技術の急速な成長により、全種類のチップ設計において性能と効率面で大きなメリットが約束されます。このコンソーシアムは、数世代先のチップにおいて、SOI 技術特有の検査と計測の課題を理解、および解決できるよう支援し、SOI ベースのデバイスを使用、または移行するすべてのチップメーカーに歩留まり面で大きなメリットを提供できるものと確信しています」

最高マーケティング責任者 (CMO)、ブライアン・トラファス (Brian Trafas)

プレスコンタクト: チャーリー・ルイス (Charlie Lewis)、KLA-Tencor Corp.、E メール : Charles.Lewis@kla-tencor.com

Lam Research Corp.

「当社の顧客がより高性能な製品を提供するためには、SOI 技術が重要な鍵となります。Lam Research が SOI コンソーシアムに参加したのは、SOI ウェーハの処理と集積に関わる今後の課題を理解するためです。こうした関わり合いを通じて、Lam は今後も、顧客のウェーハ製造に問題が発生する前にソリューションを提供するというこれまでの取り組みを継続することができます。SOI コンソーシアムに参加することで、SOI 技術のパイオニア企業との関係を構築できるほか、この最先端機能の導入を成功へと導くためのあらゆる要件に対応することができます」

グループ・ヴァイス・プレジデント兼ジェネラル・マネージャー、エッチング事業、リチャード・ゴッチョ (Richard Gottscho)

プレスコンタクト: ケレン・ホプキンス (Karen Hopkins)、グループ・ヴァイス・プレジデント兼ジェネラル・マネージャー、エッチング・ビジネス、Lam Research Corp、電話: +1-650-572-5241

NXP Semiconductors

「SOI 技術のパイオニアであり、長い期間にわたって使用してきた当社は、この技術をさらに発展させ、新たなアプリケーションを開拓していくことに誇りを感じます。このコンソーシアムは、新たな成果を促進し、それを形にしていってプラットフォームを提供します」

NXP 副社長兼最高調達責任者、デレク・ワレス (Derek Wallace)

プレスコンタクト: リエケ・デ・ジョントップス (Lieke de Jong-Tops)、NXP Semiconductors、E メール : lieke.de.jong-tops@nxp.com

Semico Research 社

「Semico は SOI 業界コンソーシアムの創立メンバーとなったことを誇り思います。当社は新しく出現する画期的な技術の発見を得意とし、3 年前に性能と低消費電力の両面で半導体の継続的な進歩を可能にする技術として SOI を見出し、この技術は現在いくつもの量産用途に採用されています。従来はバルク CMOS だった用途においても将来の世代向けとして SOI の採用が検討されており、今後の見通しは明るいと考えています」

プレジデント、ジム・フェルデハン (Jim Feldhan)

プレスコンタクト: ジム・フェルデハン (Jim Feldhan)、Semico Research 社、E メール : jimf@semico.com

Soitec 社

「20 年以上も以前より、SOI の黎明期からその可能性を確信してきた当社にとって、SOI 業界コンソーシアムの設立は、まさに心躍る瞬間です。このコンソーシアムはエンドユーザーのニーズが原動力であり、それゆえに、回路設計、基板エンジニアリング、製造、パッケージ、システム統合までの、完全なバリューチェーンを網羅するものであります。SOI は各段階で性能と機能を向上させつつ、同時に電力消費とコストを削減してきました。我々は、連携を進めながら、ベストプラクティスを共有し、より大きなエレクトロニクス・コミュニティに働きかけることで、新しい広範な市場に数々の恩恵をもたらし、あらゆる人の利益に資することが可能です」

Soitec グループ最高経営責任者 (CEO) 兼取締役会長、アンドレ-ジャック・ オーバートン - エルヴェ
(André-Jacques Auberton-Hervé)

プレスコンタクト: カミール・ ダノード-ドゥフュール(Camille Darnaud-Dufour)、コミュニケーション担当副社長、
Soitec 社、E メール : camille.darnaud-dufour@soitec.fr

STMicroelectronics

「SOI 技術を長年支持してきた ST マイクロエレクトロニクスは、経験を共有し、SOI のメリットに関する技術的な検討の場となる SOI コンソーシアムを強かに推進します」

フロント・エンド技術兼製造、アドバンスド R&D - ハイ・パフォーマンスロジック&誘導体グループ、ヴァイス・プレジデント、
マイク・ トムソン (Mike Thompson)

プレスコンタクト: マイケル・ マークowitz (Michael Markowitz)、STMicroelectronics、電話: +1-212-821-8959、E メール : michael.markowitz@st.com

米国シノプシス社

「SOI は、性能と消費電力における課題に対処するうえで大きな役割を果たすと予想されています。SOI コンソーシアム創立メンバーとして、シノプシスは回路設計と IP に関するノウハウを提供し、SOI がメインストリームとなることを支援します」

ストラテジック・ マーケット・ デベロップメント、ヴァイス・プレジデント、リッチ・ ゴールドマン (Rich Goldman)

プレスコンタクト: イヴェット・ フイゲン (Yvette Huygen)、米国シノプシス社、電話: +1-650-584-4547、E メール : yvetteh@synopsys.com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC)

「半導体業界リーダーとして TSMC は、お客様の広範にわたる製品アプリケーションをサポートするため、あらゆるコスト効果の高いバルク・ シリコン・ ベースのテクノロジー・ プラットフォームを提供します。デバイスのより高い性能やより低い消費電力を実現するため、SOI は、市場が見直すべき trade-off を持つニッチなテクノロジーの一つとして新たに登場した技術であり、業界においてもはや無視できないものとなっています。TSMC は、SOI 業界コンソーシアムの創立メンバーとして、既存および潜在性がある SOI アプリケーションをサポートするため、テクノロジー・ プラットフォームの統合および大量生産における最も優れた事例をお届けすることができます」

デザイン&テクノロジー・ プラットフォームズ、ヴァイス・ プレジデント、フーチエ・ スー (Fu-Chieh Hsu)

プレスコンタクト: チャック・ バイアーズ (Chuck Byers)、TSMC、E メール : cbyers@tsmc.com

United Microelectronics Corp. (UMC)

「SOI 業界コンソーシアムの設立メンバーに名を連ねることは大変な喜びです。このイニシアティブへの参加は、将来の SOC の性能を強化し、電力消費を削減する魅力的な技術オプションとしての SOI の採用に弾みをつけます。UMC の SOI 技術がチップデザイナーによって利用され、SOI の採用がますます広がることを期待しています」

コーポレート・マーケティング、ヴァイス・プレジデント、リー・チャング (Lee Chung)

プレスコンタクト: リチャード・ユー (Richard Yu)、UMC、E メール: Richard_Yu@umc.com